

株式会社TMH 2026年11月期 第3四半期 連結決算補足資料

東証グロース市場 / 福証Q-Board市場：280A
2026年10月15日

株主の皆さまへ



代表取締役社長
榎並 大輔

半導体市場は、AIの進化、量子コンピュータ、IoTといった技術革新を牽引役に驚異的な成長を遂げており、あらゆる産業の競争力を左右する戦略的に重要な産業として、その存在感を一段と高めています。

こうした中、世界中の半導体工場が稼働を続け、半導体製造装置の累積台数が増えるほど、当社が属する半導体製造アフターマーケット市場も着実に拡大していくと考えています。

当社は、エンジニアリングとデジタル化（プラットフォーム）の両面から半導体工場のサプライチェーンを支え、工場の安定稼働に貢献してまいりました。私たちは、**日本の半導体産業、ひいては日本のものづくりの復権に貢献するという強い使命感**を持って活動しています。半導体産業が日本の産業競争力を再び世界に示す原動力となるよう、挑戦を続けてまいります。今後とも、当社の挑戦と成長にご期待いただき、変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

AGENDA

第1部 **2026年11月期3Q 連結業績エグゼクティブサマリ**

第2部 成長戦略—中期経営計画

第3部 事業の基礎情報

事業概要・市場環境・競争優位性

Appendix

当期3Q累計 連結実績は、25.1億円の売上、122百万円の営業損失

■ 3Q累計連結実績

(単位：百万円)

項目	通期連結業績予想 (2026/7/15修正)	当期3Q累計 連結実績	予想対比 進捗状況 (差額)
売上高	3,179	2,516 前年3Q累計 6,929	79.2% (662)
営業利益	*▲276	▲122.8 前年3Q累計 209.1	損失額は通期予想の44.5%と 予想の範囲内
経常利益	▲285	▲129.0 前年3Q累計 198.0	損失額は通期予想の45.2%と 予想の範囲内

■ 売上高の通期予想に対する進捗



■ 3Q累計実績のポイント

売上高 | 修正予想の前提（受注残・販売計画）に沿って推移

損 益 | 代理店ビジネスへの先行投資を含め、計画の範囲内で推移

見通し | 通期予想の前提に変更なく、修正予想を据え置き

*通期連結業績予想には、保有している中古装置在庫の評価損の一部を織り込んでいます

前受金モデルが支える財務健全性、事業基盤は引き続き盤石

財務基盤（3Q末時点）

現金及び預金 1,496百万円

2026年5月のエクイティファイナンスにより、将来成長に向けたM&A資金を確保

CCC（現金循環日数） 34.1日

※CCC=キャッシュ・コンバージョン・サイクル
※棚卸資産回転期間+売上債権回転期間-仕入債務回転期間

流動比率 440.3%

※流動資産÷流動負債

実質自己資本比率 54.1%

※前受金〔契約負債〕控除後

事業基盤

400社超

取引顧客数 — 国内ほぼすべての半導体メーカーと直接取引口座を開設済み

200社超

グローバルサプライヤー網 — 特定調達先への依存を低減

50%超

国内半導体工場のLAYLA-EC導入比率 — 調達インフラとして定着

KPI（事業） 部品販売・修理は前年超えを確保、装置販売は調達チャンネルの多様化を推進

部品販売・修理サービスは前年超えを確保し、安定した収益源として堅調に推移
 装置販売の受注残は前年同期比68%減。調達チャンネルの多様化を進め、来期に繋がる受注の積み上げを推進

(単位：百万円)

KPI		2025年11月期 3 Q末	2026年11月期 3 Q末	YoY 増減率
未来の業績に関する指標	装置販売サービス 受注残総額	1,680	530	-68%
過去の業績傾向に関する指標 (累計)	(越境ECプラットフォーム) 部品販売・修理サービス売上高	768	778	+1%
	(エンジニアリング) 装置販売サービス売上高	6,161	1,738	-72%
生産性に関する指標 (売上高・純利益は累計)	従業員一人当たり売上高	169	50	-70%
	従業員一人当たり純利益	3.3	▲ 1.8	—

受注残とは受注契約から将来に期待される収益の総額を意味しております。つまり、受注残が積み上がることは将来の業績への寄与が見込まれることになります

当期の事業トピックス グローバル販売力・技術力の強化

更なる販売強化・成長を目的として、中国に子会社を設立

概要

■ 2026年10月より 中国（上海市）子会社の稼働開始

- ・中国国籍の社員複数名が現地に常駐

■ 法人設立の狙い

①顧客深耕

- ・エンドユーザーとの直接取引、現地での人脈構築・ホットライン構築
- これにより、利益率の向上、中国市場における競争優位性の強化、ならびに資金回収力の強化を図る

②新規ビジネス構築

- ・将来的に、現地における半導体関連材料/部品などの製造・加工・販売も検討



①顧客深耕

仲介会社を通さずエンドユーザーへ直接販売

< 中国法人設立前 >

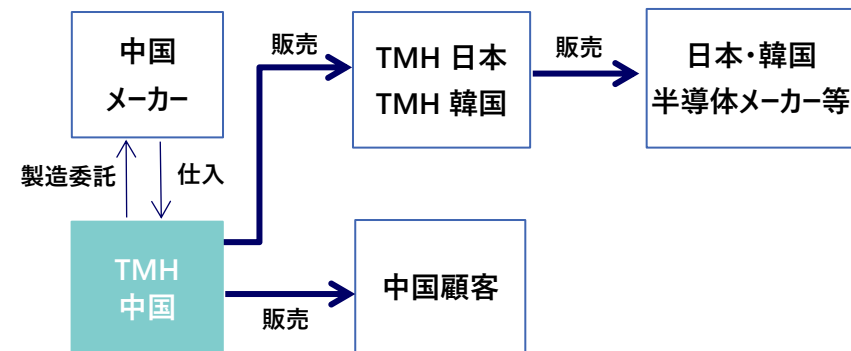


< 中国法人設立後 >



②新規ビジネス構築

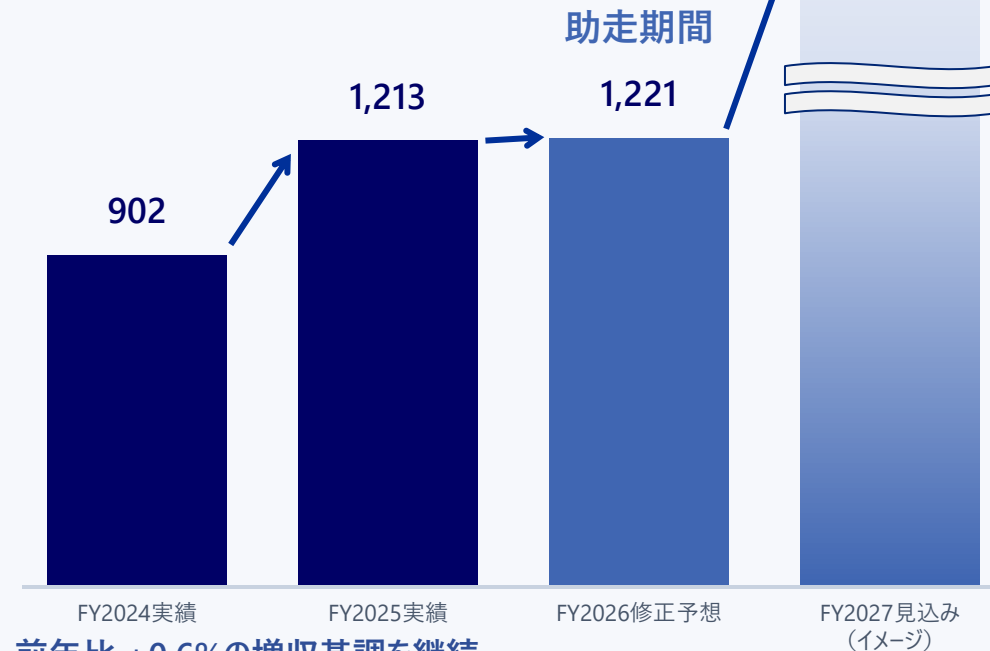
中国の補助金及び生産体制・基盤を利用して、日本等へ販売し、サプライチェーンを強化



越境EC：部品販売・修理サービスは増収継続、FY2027に再加速へ

越境EC等を活用した部品販売・修理サービスは、サプライヤー基盤の強化により再加速を計画

部品販売・修理サービス 売上高の推移（百万円）



前年比 +0.6%の増収基調を継続

LAYLA関連売上はFY2022以降CAGR +34.9%で拡大

FY2027 再加速ドライバー：サプライヤー基盤の強化

- 米国大手半導体材料メーカーであるインテグリス社の日本法人と国内販売代理店契約を締結
- 同社の材料・消耗材は半導体の生産量に連動する反復購買型で、ストック型収益の拡大に直結

世界有数の材料メーカーとの連携により、
調達力・取扱領域を拡大し、EC事業の再加速を企図

AGENDA

第1部 2026年11月期3Q 連結業績エグゼクティブサマリ

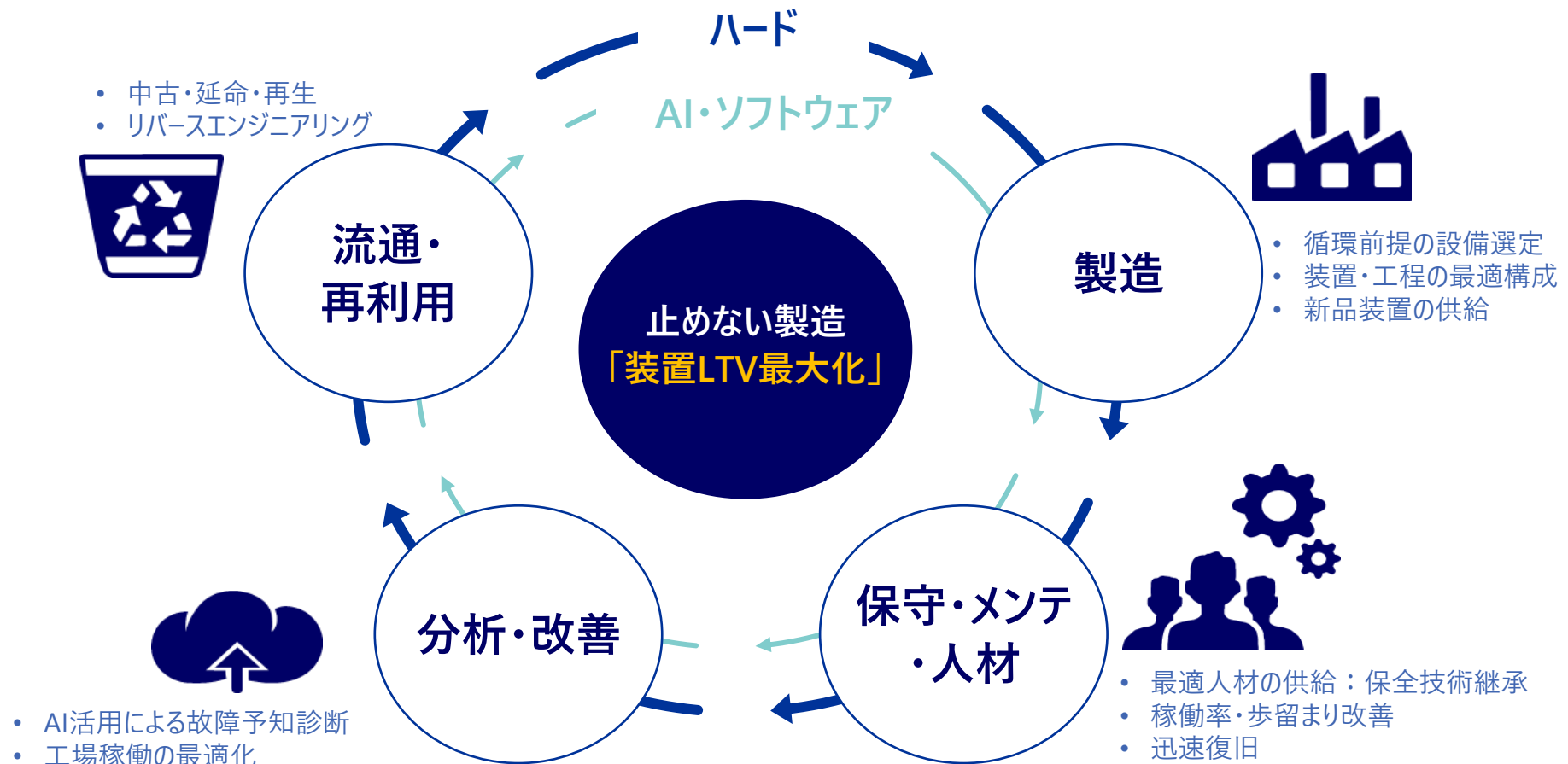
第2部 成長戦略—中期経営計画

第3部 事業の基礎情報
事業概要・市場環境・競争優位性

Appendix

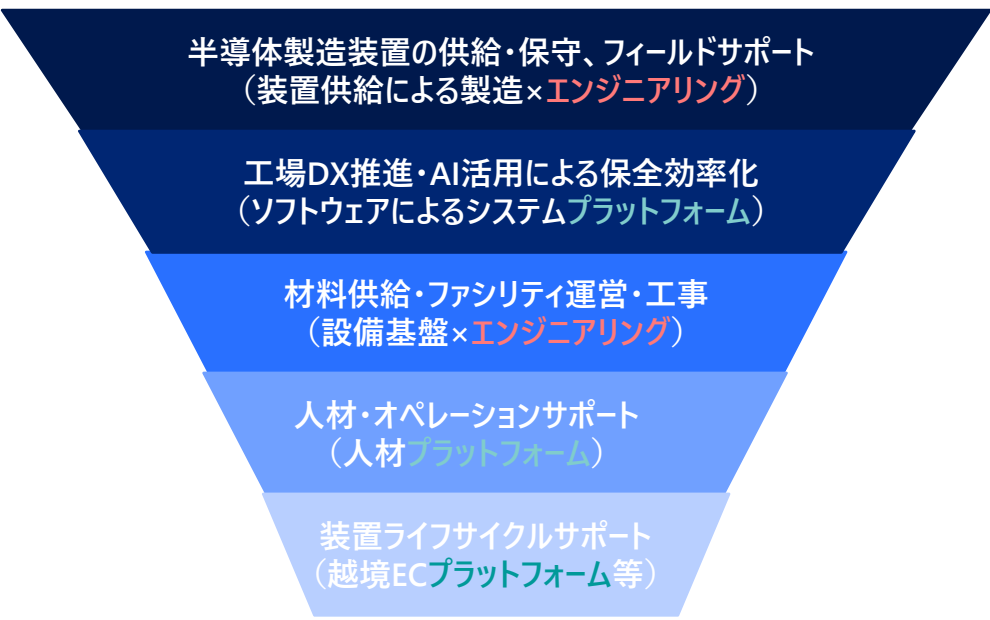
- 資源枯渇、紛争・分断など不確定要素が高まる社会では、「止めない製造」を実現するための循環設計が重要視
- 「故障予知により稼働を止めない」、「稼働率・歩留まり・人材定着まで含めた価値提供」、新品前提から「循環型」へ

循環設計



TMHは、アフターサービスを担う装置ライフサイクルサポートから、仕組みとシステムによるプラットフォームを通じて半導体製造を統合的に支援する「半導体製造インテグレーター」へと進化する

Vision1000



半導体製造インテグレーターへ 工場の多様な課題をエンジニアリング×プラットフォームにより解決	
製造	サービス：工場全体の運営受託、生産性改善・コスト最適化の請負契約 収益モデル：工場運営全体の包括契約、高付加価値モデル
DX・AI予知保全	サービス：DX推進/AI活用により、半導体工場のレガシーシステムの改善・刷新 収益モデル：SaaSモデル、ソフトウェア利益率による高収益化
材料供給 ファシリティ管理 工事	サービス：薬液・ガス供給の安定運用、純水・空調・廃棄処理など工場インフラ管理、工事 収益モデル：ストック型収益＋高収益率
人材・ オペレーションサポート	サービス：人材プラットフォームサービス、エンジニア教育・研修プログラム 収益モデル：継続契約化（準ストック型）
装置ライフサイクル サポート	サービス：越境ECを活用した部品販売・修理サービス、エンジニアリング力を活かした 装置販売、その他付帯エンジニアリングサービス 収益モデル：単発取引あり、一部準ストック型

ホワイトスペースを埋めていくことが、半導体工場の稼働継続に必要な要件を充足
「止めない製造」の実現へ

オーガニック成長を加速させるとともに、インオーガニック成長への施策に取り組み、Vision1000の達成へ



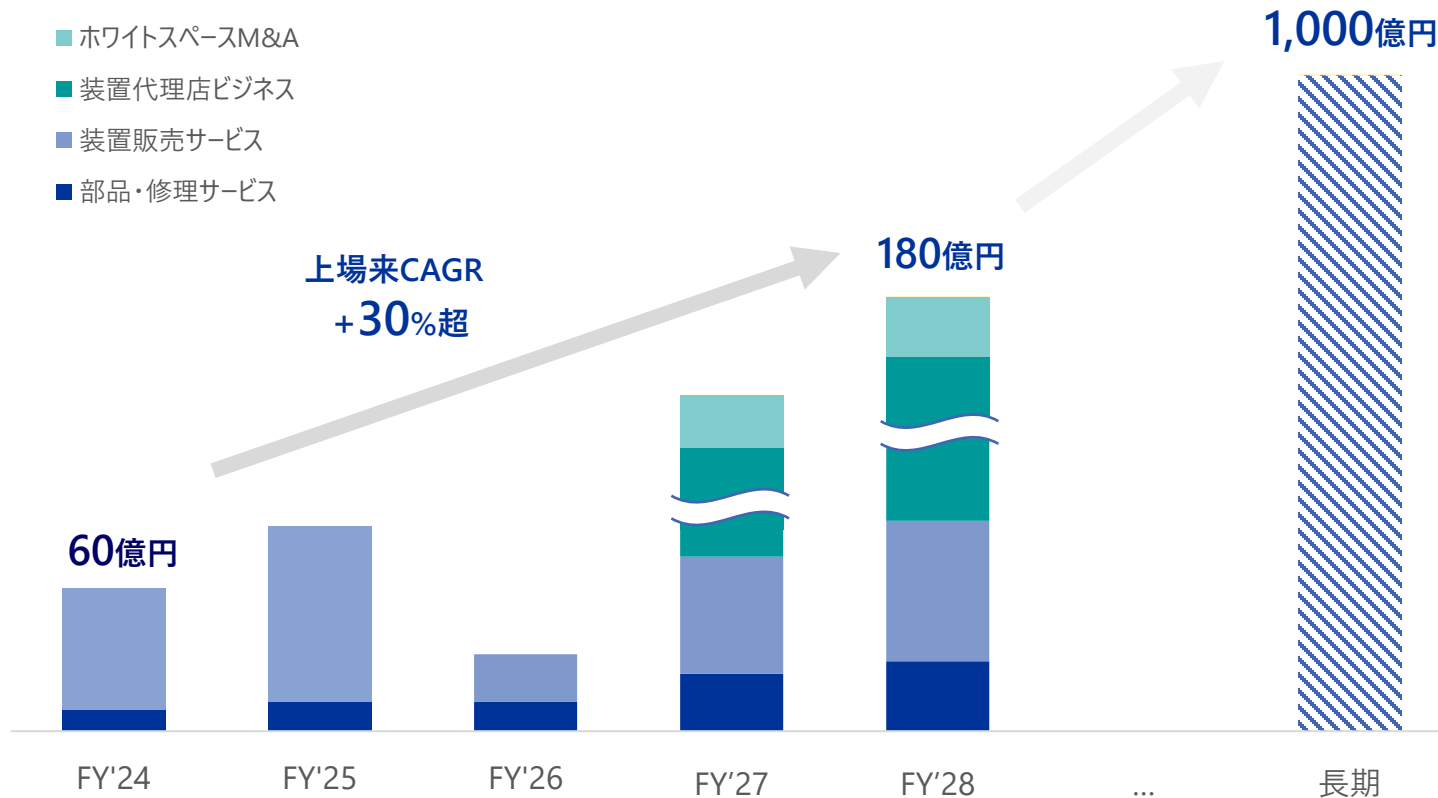
*売上高については流通総額の情報として記載しております

中長期成長イメージ（売上高）

代理店とM&Aでポートフォリオを広げ、中長期で売上高1,000億円への成長を目指す

- 中長期的には**代理店ビジネス**、**ホワイトスペースM&A**を成長ドライバーに加え、更なる成長を図る
- 半導体装置の代理店は単なる仲介業者に留まらず、各装置メーカーの国内におけるいわば“顔”の役割
当社のプラットフォーム力・エンジニアリング力の発揮、強化により既存事業とのシナジーを創出

売上高（流通総額）推移



ホワイトスペースM&A

当期より取り組みを始めたM&Aに関して、本中計期間中の実行に向けて進捗。中長期のトップラインを押し上げ

代理店ビジネス

韓国装置メーカーと、国内取扱における独占代理店契約締結
既にFY2027の売上につながる具体的な引き合いがあり、
1台3億円以上×年間数台～数十台の受注確度高

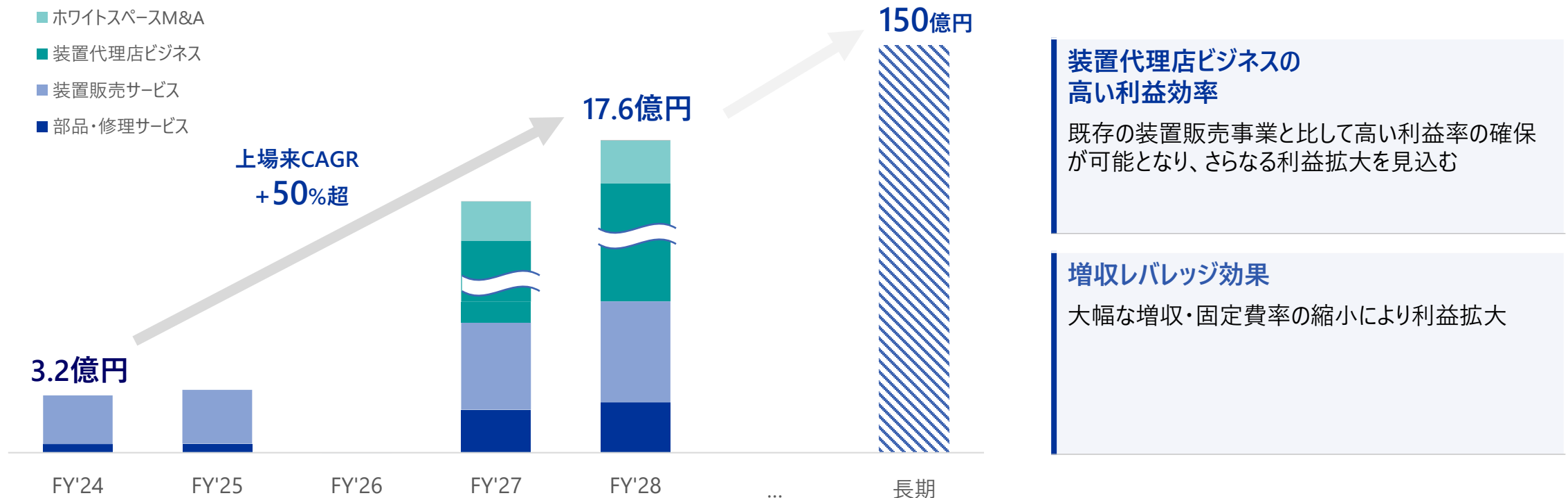
中長期成長イメージ（営業利益）

高利益事業の成長と収益構造の進化により、営業利益150億円の達成を目指す

- 装置代理店ビジネス、ホワイトスペースM&Aを成長ドライバーに加え、更なる成長を図る
- 利益効率の高い装置代理店ビジネスの成長、増収に伴う固定費率の縮小により

営業利益は上場来CAGR+50%超へ

営業利益推移



中期経営計画
FY2028では営業利益17.6億円への飛躍的な拡大を目指す

- 調達機会の一時的な減少による装置販売の減収と、代理店ビジネス向け採用費用の先行計上等により、FY2026は減収・営業損失を見込む
- 中期的には新規事業である装置代理店ビジネスの拡大およびホワイトスペースM&A、これらのシナジー効果により
営業利益17.6億円を見込む

CAGR (単位：百万円)

	FY2025 実績	FY2026 修正後予想	FY2027 計画	FY2028 計画	FY2028 -FY2025比 (増減率)
売上高	8,628	3,179	10,336	12,805	+4,176 (+48.4%)
売上高（流通総額）*	8,628	3,179	14,153	18,291	+9,662 (+112.0%)
売上総利益	970	443	2,967	3,457	+2,486 (+256.3%)
（売上総利益率）	11.2%	14.0%	28.7%	27.0%	+15.8pt
営業利益	355	▲276	1,421	1,767	+1,411 (+396.9%)
（営業利益率）	4.1%	－%	13.8%	13.8%	+9.7pt

* 装置代理店ビジネスのうち、財務諸表上の売上高と売上原価が純額計上となるものを、総額計上とした場合の数値

AGENDA

第1部 2026年11月期3Q 連結業績エグゼクティブサマリ

第2部 成長戦略—中期経営計画

第3部 事業の基礎情報

事業概要・市場環境・競争優位性

Appendix

企業理念

Vision1000の実現に向け、新生TMHの組織風土の礎となるMission・Vision・Valueを再構築



株式会社TMHは、**T**echnology **M**akes **H**appinessの
頭文字から社名が構成されています

MISSION

Technology Makes Happiness

人とテクノロジーの力で、半導体の未来を支え、社会の進化に貢献する企業体へ

VISION

人が育ち、価値が生まれ、世界市場を創る企業へ

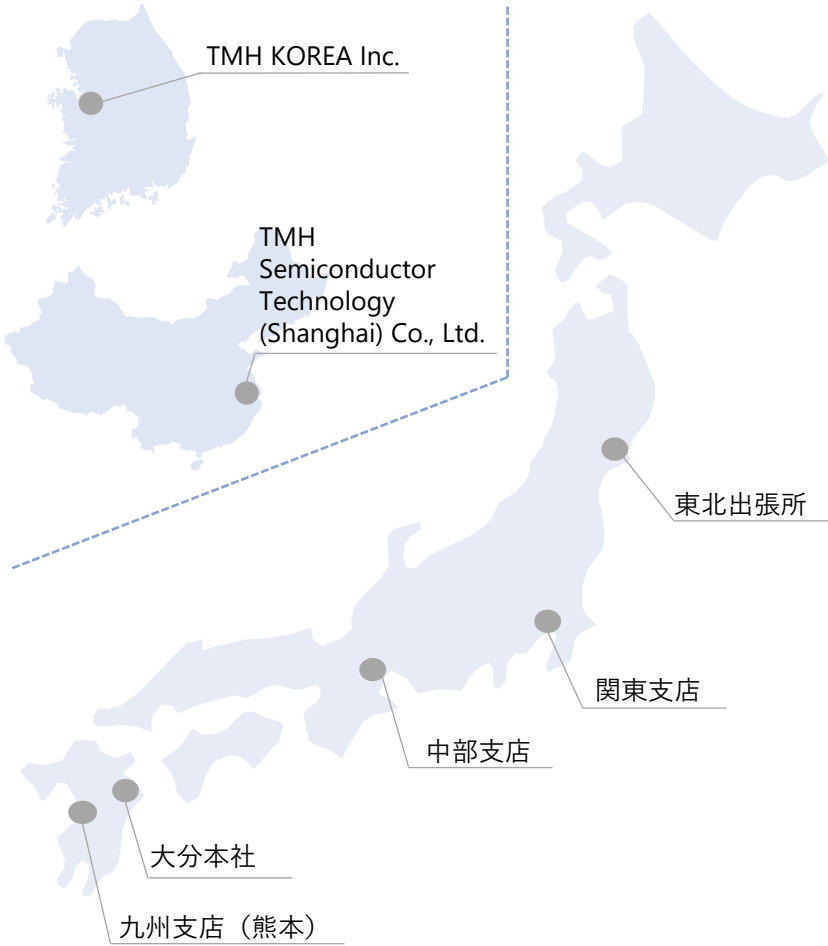
VALUE

I. 個	V1	自由に挑み、責任でやり切る	II. 対顧客	V3	お客様に、もてるすべての力で	III. 組織	V5	枠を越えて、ひとつで挑む
	V2	まだ見ぬ可能性を、結果に変える		V4	期待を超えてこそ、信頼になる		V6	個性を束ね、世界を切り拓く

会社概要

会 社 名	株式会社TMH
代 表 取 締 役 社 長	榎並 大輔
所 在 地	大分県大分市下郡北3-14-6
設 立	2012年3月9日
従 業 員 数	50名（2026年8月末時点、連結ベース）
資 本 金	3億1,289万円（2026年8月末時点）
事 業 内 容	半導体製造フィールドソリューション事業 （装置・部品の販売・修理、 越境ECサイトLAYLA-ECの運営）
事 業 所	大分本社・中部支店・関東支店 東北出張所・九州支店（熊本）
海 外 子 会 社	2社（韓国 平澤市、中国 上海市）

国内**5拠点**＋**韓国・中国**に展開



マネジメントチーム

半導体製造装置の専門家が不足するなか、半導体・サプライチェーンの専門家にて構成



榎並大輔 Taisuke Enami
代表取締役
CEO

早稲田大学卒業後、株式会社東芝に入社。
東芝在籍中にサプライヤー管理に課題を感じ独立。
2020年には大分県から地域牽引企業として選定



香月賢一 Kenichi Katsuki
取締役 CPO

株式会社東芝入社後、20年以上購買・調達に従事。2012年には
東芝本社で半導体部門の材料調達を担当。年間数十億円のコス
トダウンや改善を実現。2016年にTMHに参画



関真希 Maki Seki
取締役 CFO

大手事業会社、デロイト・トーマツコンサルティング社にて経営改
革に従事。グローバルコスト構造の可視化、M&A等サプライチェ
ーン観点から多数のプロジェクトに従事。2015年にTMHに参画

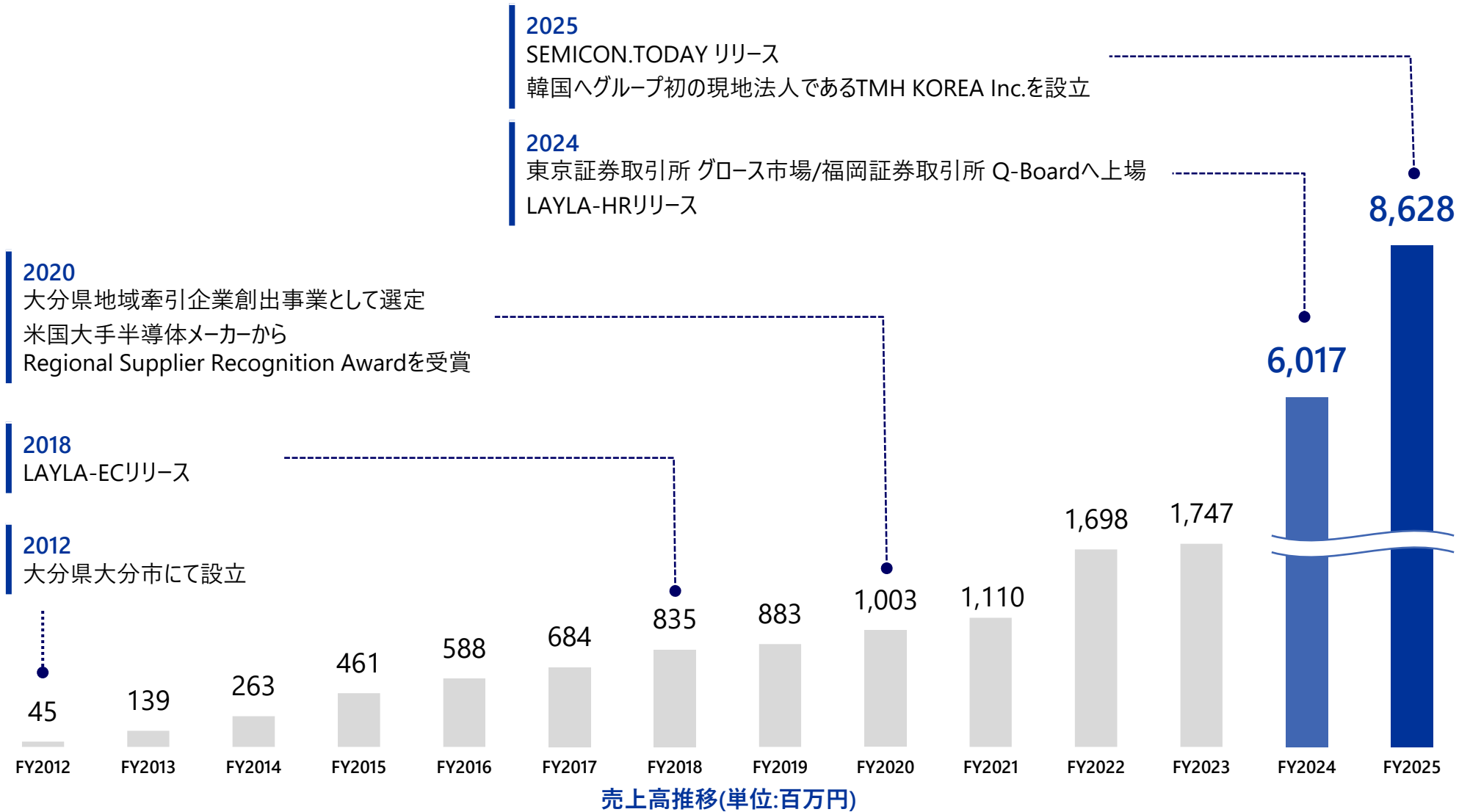


野木村修 Osamu Nogimura
社外取締役

名古屋大学卒業後、日立製作所に入社。
ルネサステクノロジ生産本部長、ルネサスエレクトロニクス執行役員
生産本部本部長、ルネサスセミコンダクターパッケージ&テストソリューションズ
代表取締役社長を歴任。一貫して半導体製造部門に従事

沿革

LAYLAプラットフォーム、装置販売事業の拡大により設立から継続して成長





半導体業界が直面する様々な社会課題を解決する リーディングカンパニー

領域	提供する価値	特徴
巨大な 半導体業界	半導体製造装置の延命 メンテナンスコストの軽減	ニッチトップ かつ 高成長

当社が必要とされる背景

老朽化した半導体工場には、多様なサプライチェーン課題が山積した状態

調達課題

- 日本の工場の多くは**陳腐化・老朽化が進み**、**レガシー**半導体製造装置が多く、**部品の調達が困難**
- レガシー半導体製造装置部品の調達は、属人的な調達手法が中心（**デジタル化の遅れ**）

製造課題

- IoT（Internet of Things）による急速な需要の高まりにより、**旧型装置の需要が継続**
- 長期的な国内半導体市場の低迷により、**エンジニア人材が枯渇**
- レガシー半導体工場では**設備保全の属人化が常態化**、装置トラブルが品質問題や大規模な納期遅延に発展

物流課題

- 部品取りのために購入した**旧型装置の保管が常態化**することで**生産スペースを圧迫**

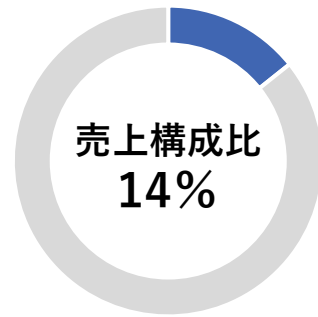
当社が目指す未来

半導体製造に関する多様な課題を解決し、
日本のものづくりの復権を支えます

半導体工場へのトータルソリューションサービスを提供

越境ECプラットフォーム等を利用した部品販売・修理サービス

世界中の半導体製造装置・部品の売買にプラットフォームを活用

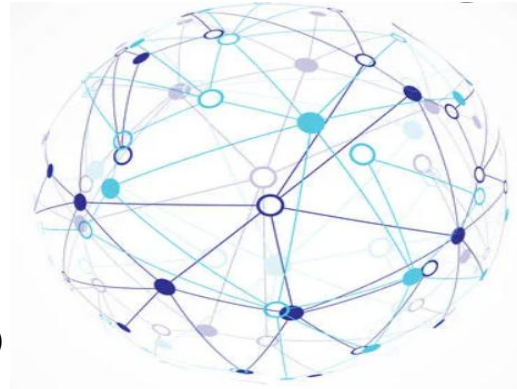


【サービス内容】

- ✓ 希少部品の供給
- ✓ 幅広い修理サービスの提供

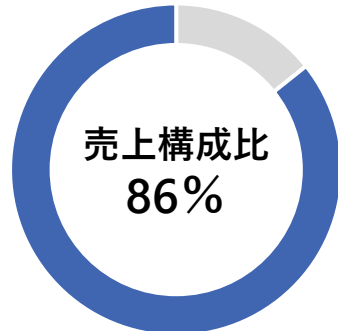
【実績】

- ✓ 200社超の優良なグローバルサプライヤー（多種多様なメンテナンスや部品供給）
- ✓ 36.5万点超のアイテム数、50%超の国内半導体工場が導入済み



エンジニアリング力を活用した装置販売サービス

装置解体、移設、搬出、プロセスチューニング、立上げサービスを提供



【サービス内容】

- ✓ 専門性が必要な装置の解体から搬出まで一気通貫でのサービス提供
- ✓ 旧型装置のプロセスチューニングによる歩留まりの改善

【実績】

- ✓ 米国大手半導体メーカーからサプライヤーアワード受賞
- ✓ 過去の実績を持つ信頼性（半導体製造装置の取引、100台超）

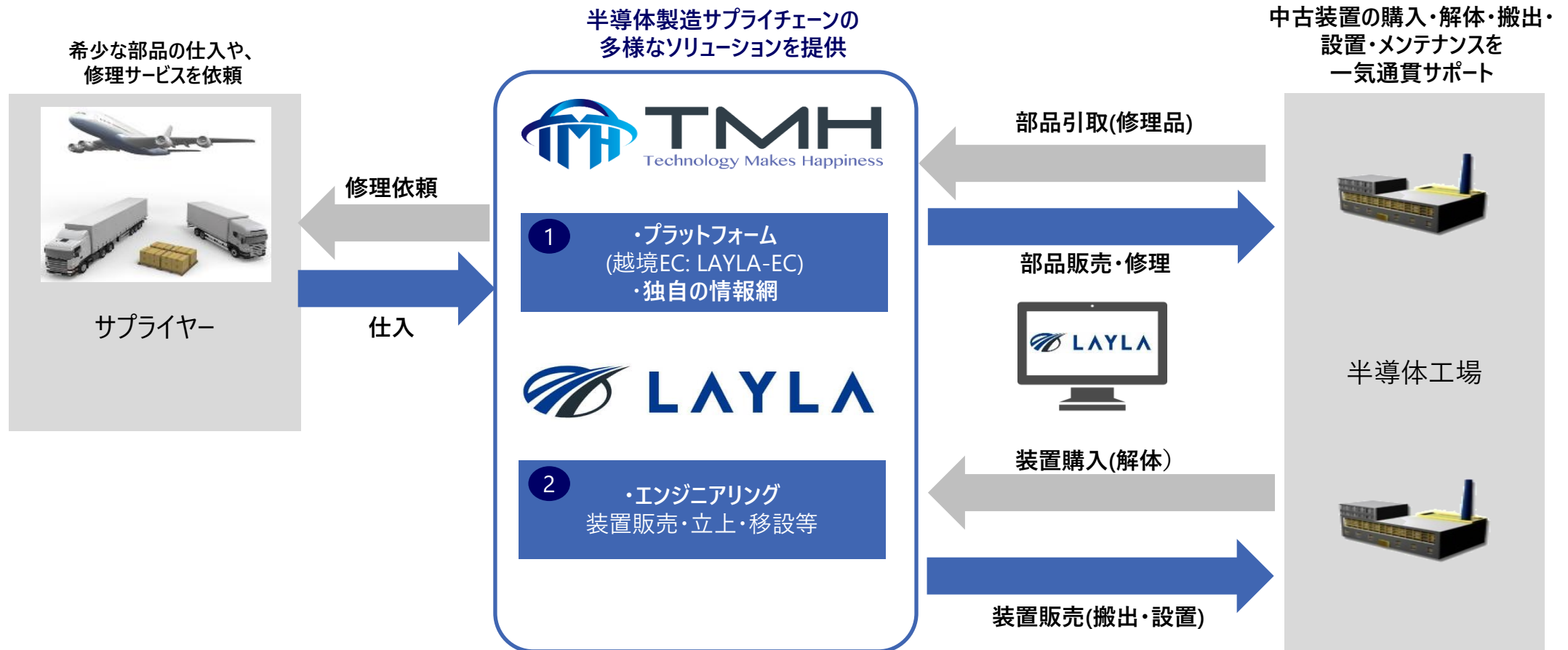


売上構成比は2025年11月期実績

ビジネスフロー

ECプラットフォームとエンジニアリングを融合し、半導体工場の持続的な稼働を支援

- 世界中のエンジニアリング会社やサプライヤーと協業し、部品の修理や販売、歩留まりの改善、不要装置・部品の買取など、お客様の課題に対して幅広いソリューションを提供
- LAYLAでは世界中の装置・部品のデータを集積し、半導体製造装置の調達プロセスを効率化
半導体工場における半導体製造装置の効率的な運用と持続可能性に貢献

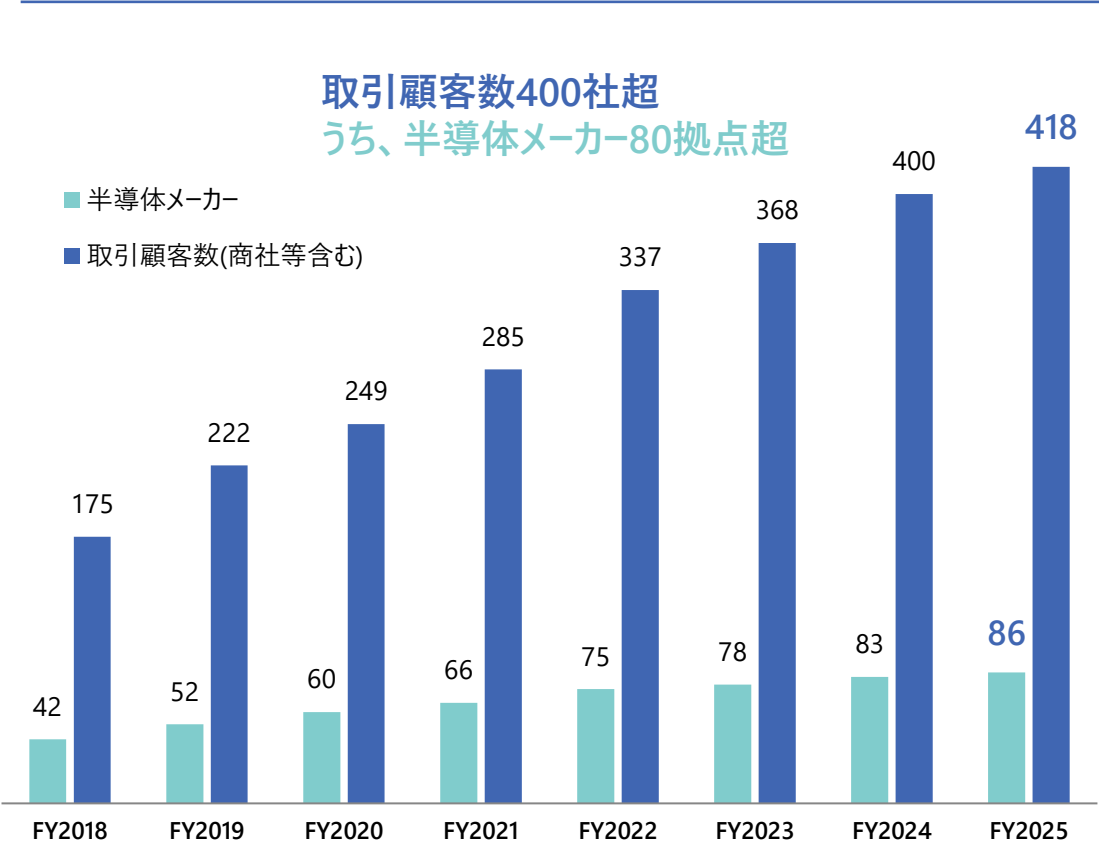


顧客

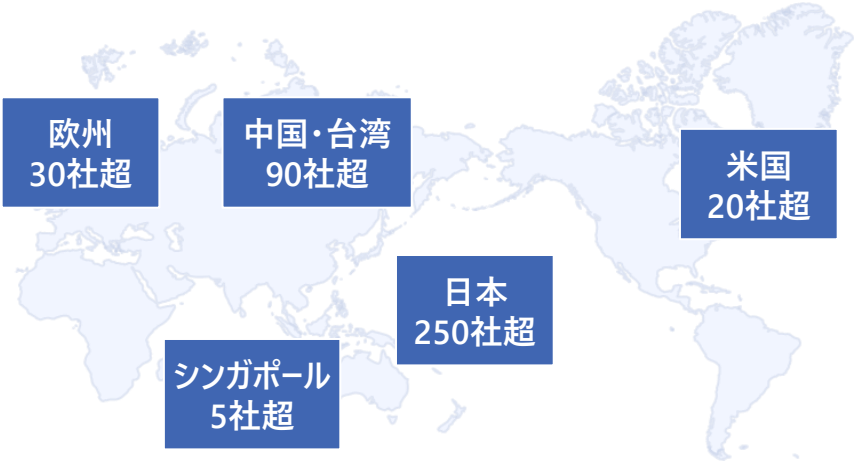
越境ECサイトを活用した圧倒的な調達力により、国内の半導体メーカーとの直接取引を拡大

- 国内ほぼすべての半導体メーカーと直接取引口座を開設済み
- 顧客のうち半導体メーカーは80拠点超。その他顧客も含めて全ての取引顧客数で400社超
- LAYLA-ECの展開により、海外半導体メーカーとの取引も拡大

顧客数推移



国別クライアントマップ



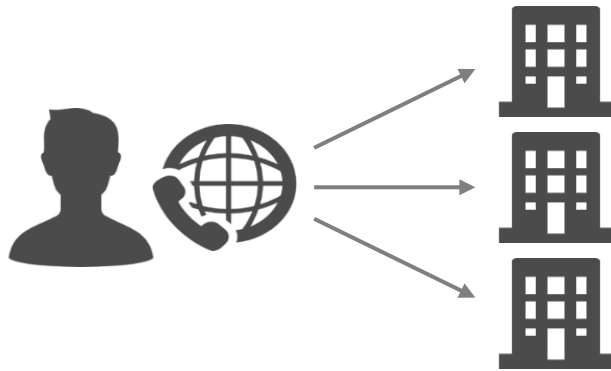
主な取引実績

- ・ キオクシア
- ・ テキサスインスツルメンツ
- ・ ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング
- ・ ルネサスエレクトロニクス
- ・ SUMCOグループ
- ・ 東芝グループ
- ・ ラピス 他

LAYLAが提供する価値 世界中の実在庫が可視化できるプラットフォームを確立

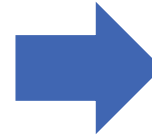
- 従来の調達方法では困難だった実在庫の可視化を実現し、**半導体製造装置の調達活動を効率化できるプラットフォームを提供**

従来の調達方法



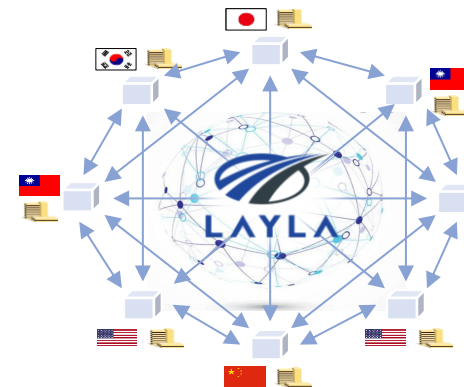
- 調達担当者が、必要な情報を各社に個別で問い合わせなければならないため、**必要な情報が限定される**
- 従来の調達方法では納品まで、**時間、コストがかかりすぎる**
- 調達ルートが限定されてしまうため、**独自に調達ネットワークを確立する必要がある**

老朽化した製造装置の部品調達が困難



LAYLA

商品数**36.5**万点超



世界中の
点在している
部品を集約

- **実在庫を24時間365日確認可能**
- 可視化された実在庫の**価格、納期、保証期間、状態まで確認可能**
- TMHが販売窓口として機能するため、エンドユーザーが安心して購入できる環境を実現(安心保証)

半導体工場のDX化に貢献

ビジネスフロー 装置売買プロセス

装置売買の前提となる解体作業ノウハウが当社にあることが売買加速に

- 装置売買において最も重要となる解体工程を内製化
高度なエンジニアリング力により迅速かつ信頼性の高い取引を実現



AGENDA

第1部 2026年11月期3Q 連結業績エグゼクティブサマリ

第2部 成長戦略—中期経営計画

第3部 **事業の基礎情報**

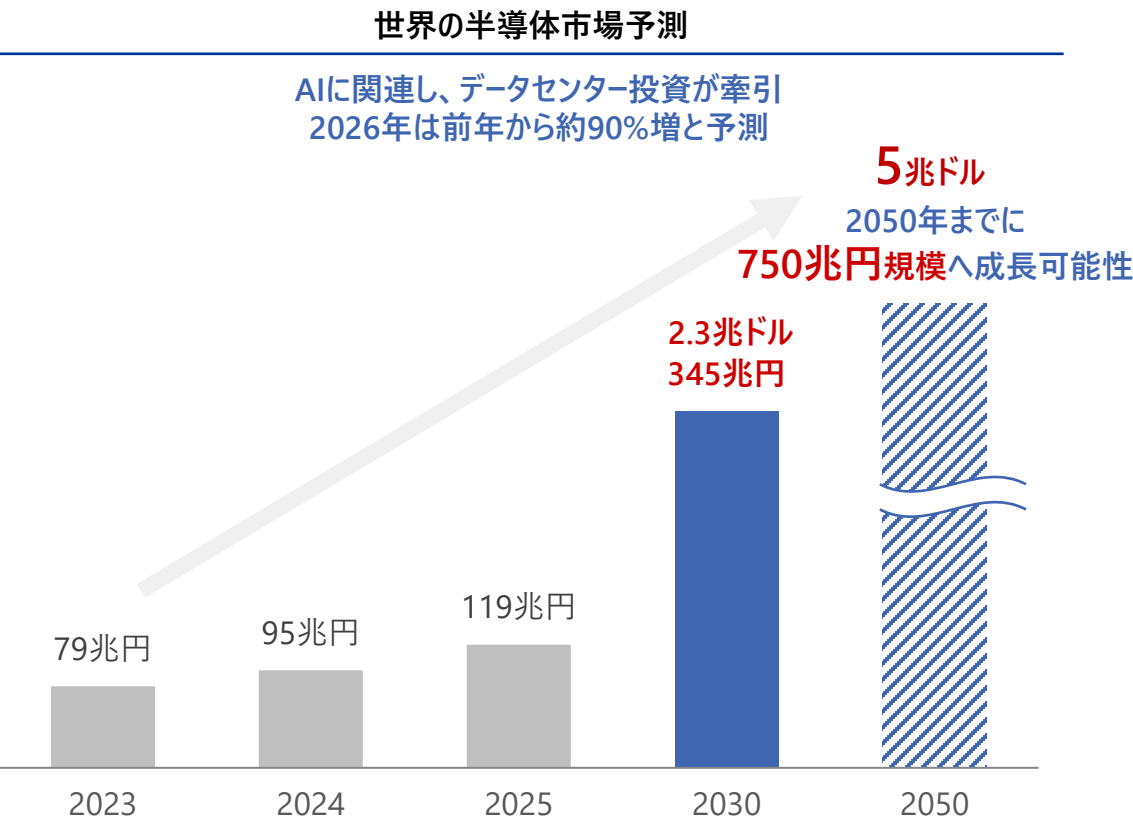
事業概要・**市場環境**・競争優位性

Appendix

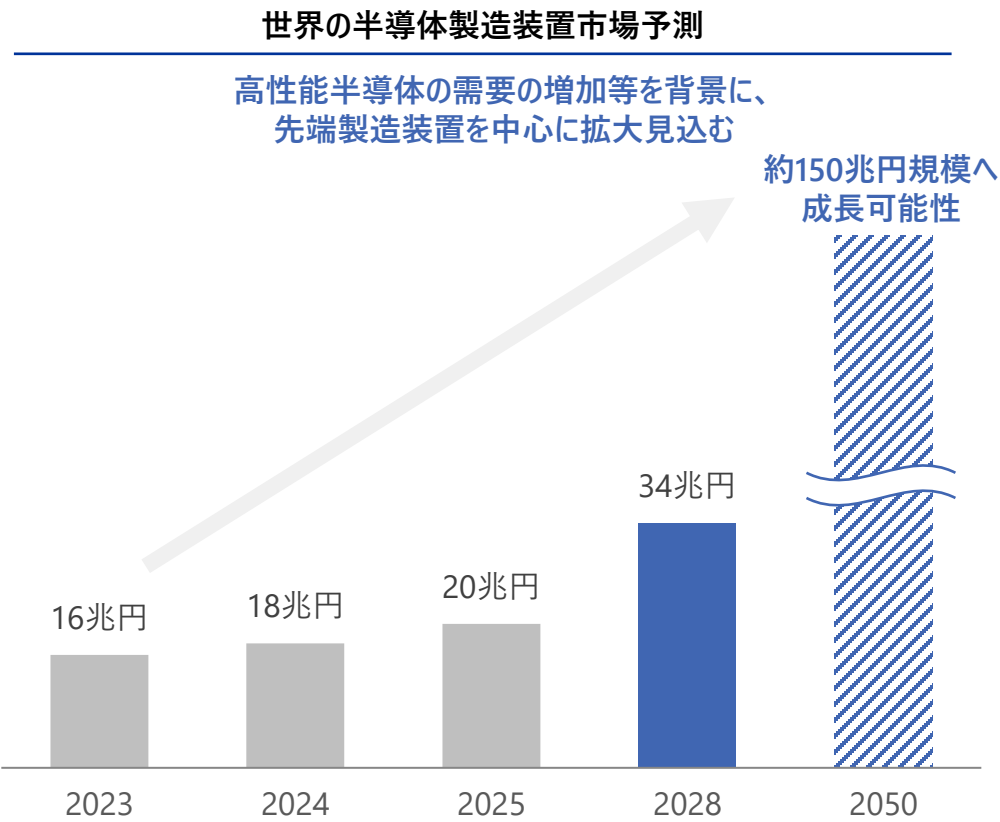
世界の半導体市場規模

2030年に345兆円規模へ、市場ポテンシャルの更なる高まりが当社の成長戦略を後押し

- 世界の半導体市場は、AI需要に関連した投資が牽引し、2026年に初めて1兆ドルを突破、2030年までに345兆円（2.3兆ドル）まで急拡大の予想
長期的には、2050年までに750兆円（5兆ドル）へ成長する可能性
- 当社が中長期ターゲット市場と見据える半導体製造装置市場についても順調に拡大



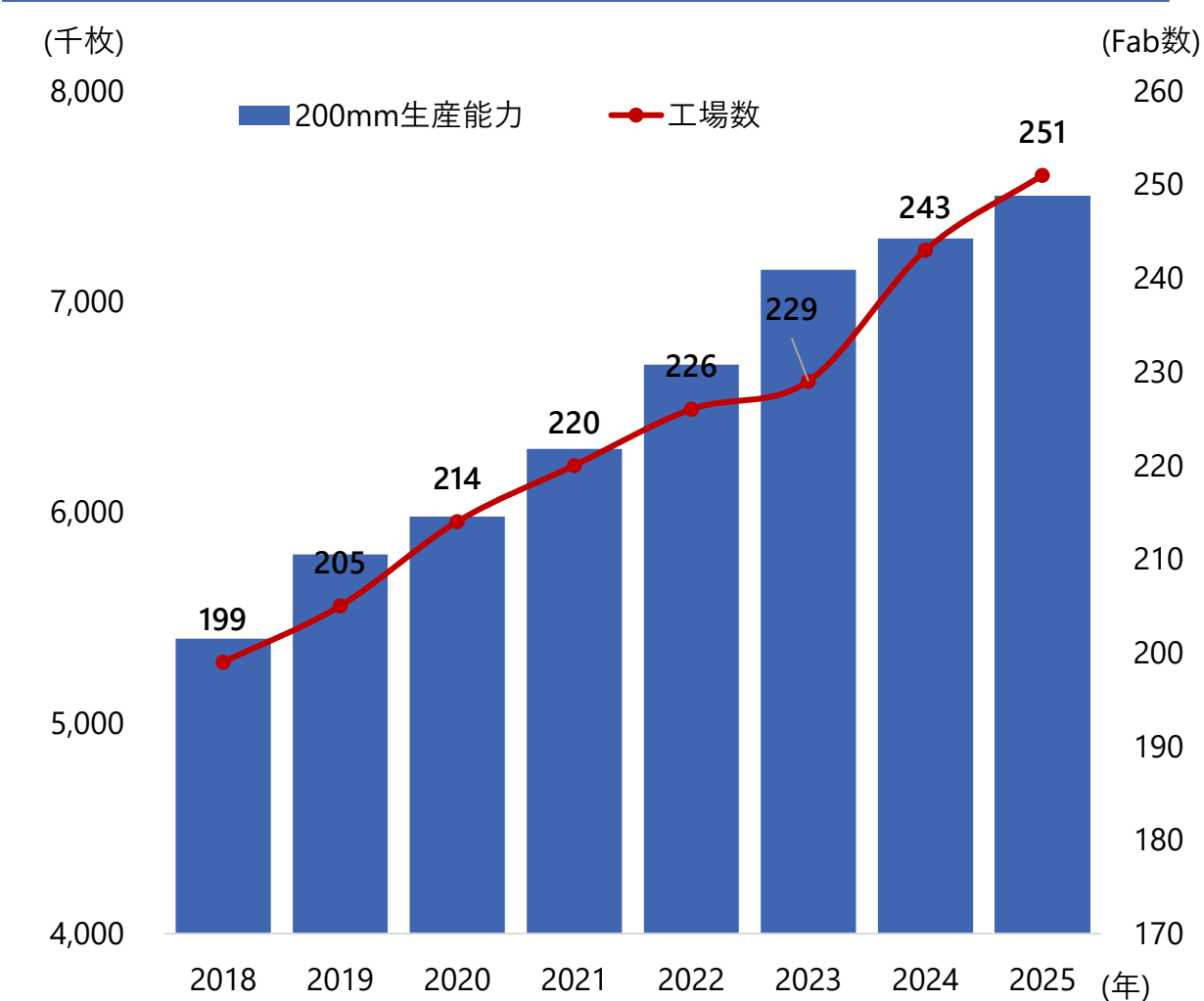
出所：(一社)WSTS日本協議会「WSTS 2026年春季半導体市場予測について」(2026年6月)
McKinsey & Company「The \$2.3 trillion horizon」(2026年9月) ※150円/USDにて日本円換算
東京エレクトロン(株) コーポレートサイト「The Future of the Semiconductor Industry and its People」



出所：SEMI「世界半導体製造装置の2025年末市場予測」(2023・2024年)、
同「装置市場統計」(2025年実績)、同「年央市場予測」(2026年7月、2028年予測)を元に試算
2050年は、2025年実績から半導体市場全体と同じ成長率で推移すると仮定し算出
※150円/USDにて日本円換算

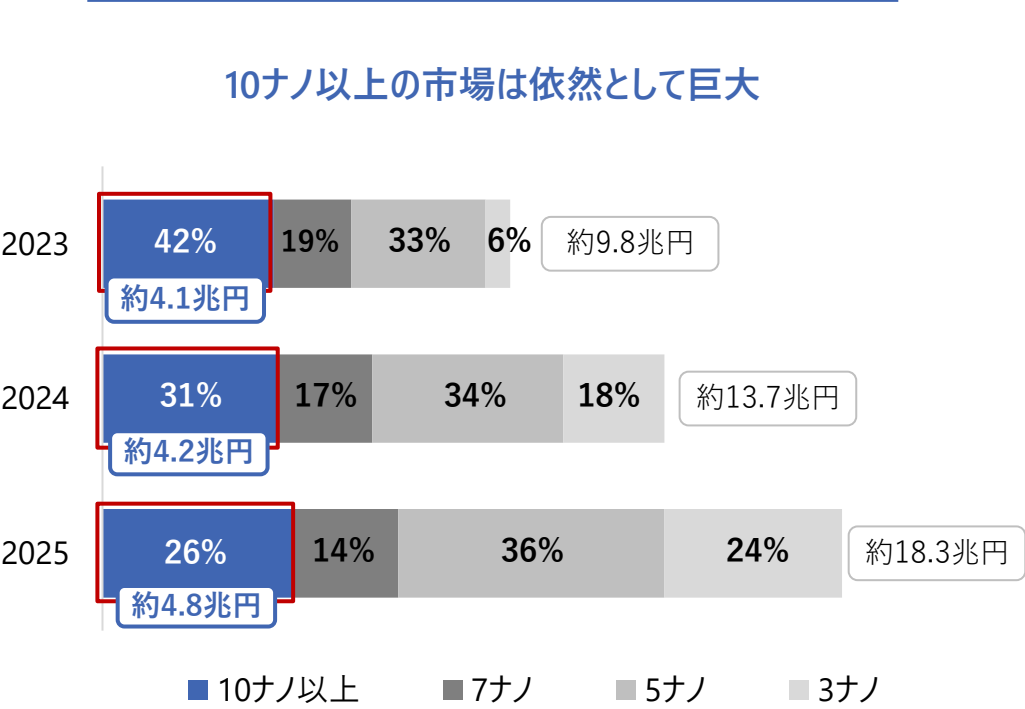
レガシー半導体の旺盛な需要
半導体不足により200mm工場の生産能力が急成長へ、先端企業でもレガシー半導体は主力

200mmウエハファブ数と生産能力推移



出所：SEMI「200mm Fab Outlook」2Q 2026 Update
※2024・2025は最新公表情報に基づく実績ベース（生産能力は公表値を丸めて表示）

TSMCのプロセス別売上構成



為替：1NTD = 2023年 4.68円、2024年 4.73円、2025年 4.81円
売上高：2023年 約2兆1,000億NTD、2024年 約2兆8,943億NTD、
2025年 約3兆8,091億NTD

出所：TSMC 開示資料より当社作成（2023年、2024年、2025年通期実績）
2025年の為替は、三菱UFJリサーチ&コンサルティング公表の2025年平均TTM
（1USD=149.71円）とTSMCのドル建て売上高（約1,224億ドル）から算出



世界市場における旧型半導体製造装置の重要性

「最先端装置」だけでなく、多様な用途に適応する「旧型装置」の需要も高い

- 最先端工場への投資が活発である一方、旧型半導体に関する需要も依然として高く、

旧型半導体製造装置の保守は、最先端半導体開発と同様に重要なテーマである

	市場の現状	投資動向
最先端	生成AI関連の需要旺盛等を背景に、データセンターやスマートフォン等、高性能な最先端半導体の需要は極めて高い状況	国内では官民協力により、TSMC関連投資や、微細化技術の開発など、数兆円規模の投資が進展 国外においても、米国や韓国をはじめ、覇権をめぐる国策としての大規模な投資が活発化
旧型	IoT製品や自動車関連などを中心に、旧型半導体が用いられるパワー半導体やセンサー等の需要が高まるとともに、低～中程度の性能の半導体の需要も旺盛 これらを担う <u>20年以上前に投資された半導体製造装置も現役で稼働</u> している状態であり、国内で稼働している半導体工場の <u>8割以上がウエハサイズ200mm以下のレガシー工場</u> である	旧型半導体製造装置は現在も重要性が高く、例えばインドがレガシー工場を中心として包括的に支援するISMを国策として発足 <u>装置の保守</u> （EOL部品の調達、修理、中古装置の購入や立上・改善など）に対しての <u>グローバルな投資が進展</u>

< 200mm / 300mmウエハサイズ工場について >

半導体チップを製造する材料であるウエハの直径サイズを意味しております

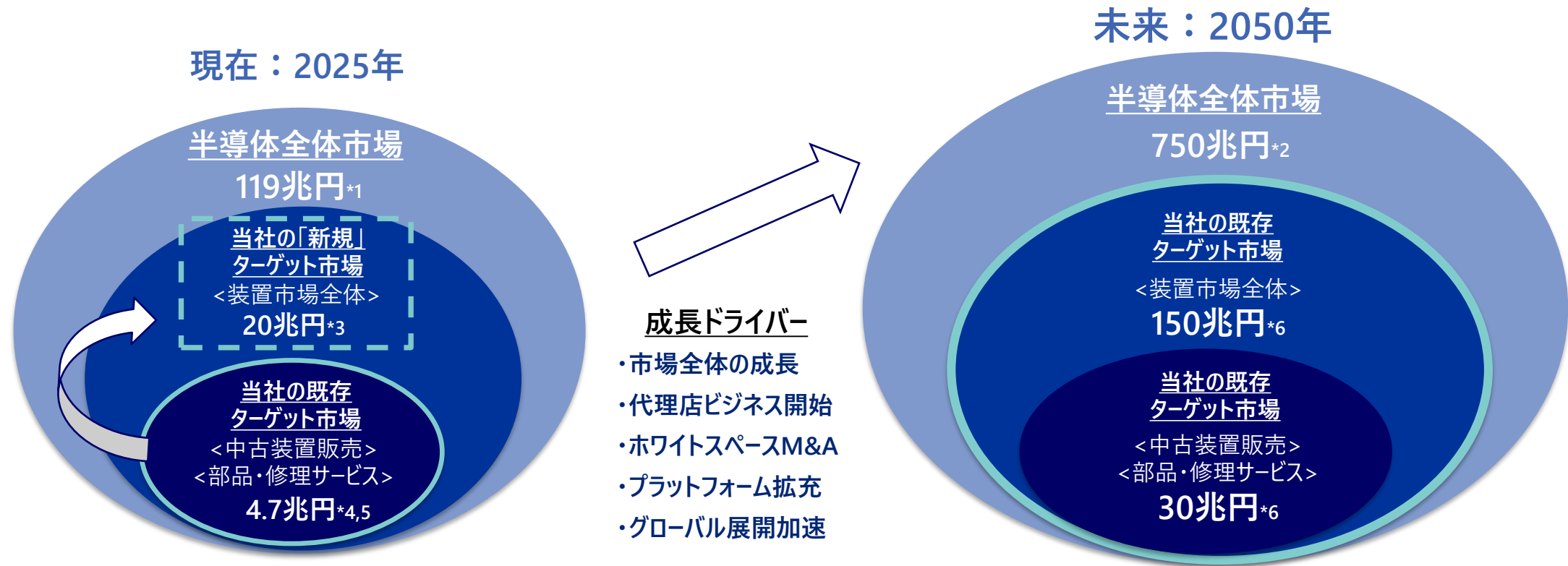
200mmウエハは、過去に広く使われてきた標準的なサイズですが、現在では生産効率の高いより大きな300mmのウエハが主流になっております

200mmウエハを使っている工場は、古い技術を使っていることが多く、レガシー工場と呼ばれることがあります

ターゲット市場

代理店ビジネスとM&Aにより、ターゲットを20兆円規模の「装置市場全体」へ拡大する

- 既存事業のターゲット市場は、半導体市場のうち、中古半導体装置市場、部品・修理サービス市場である
- 半導体装置代理店ビジネスの開始や、今後見込まれるM&A戦略により、
中長期的には半導体製造装置市場全体をターゲット市場と見据える



^{*1} 出所：(一社)WSTS日本協議会「WSTS 2026年春季半導体市場予測について」

^{*3} 出所：SEMI「装置市場統計」（2025年実績）を元に試算

^{*6} 2050年は、2025年実績から半導体市場全体と同じ成長率と仮定し算出

^{*2} 出所：東京エレクトロン 株式会社「The Future of the Semiconductor Industry and its People」

^{*4} 出所：The Business Research Company「中古半導体装置の世界市場レポート 2025年」 ^{*5} 半導体製造装置市場の20%と仮定

※150円/USDにて日本円換算

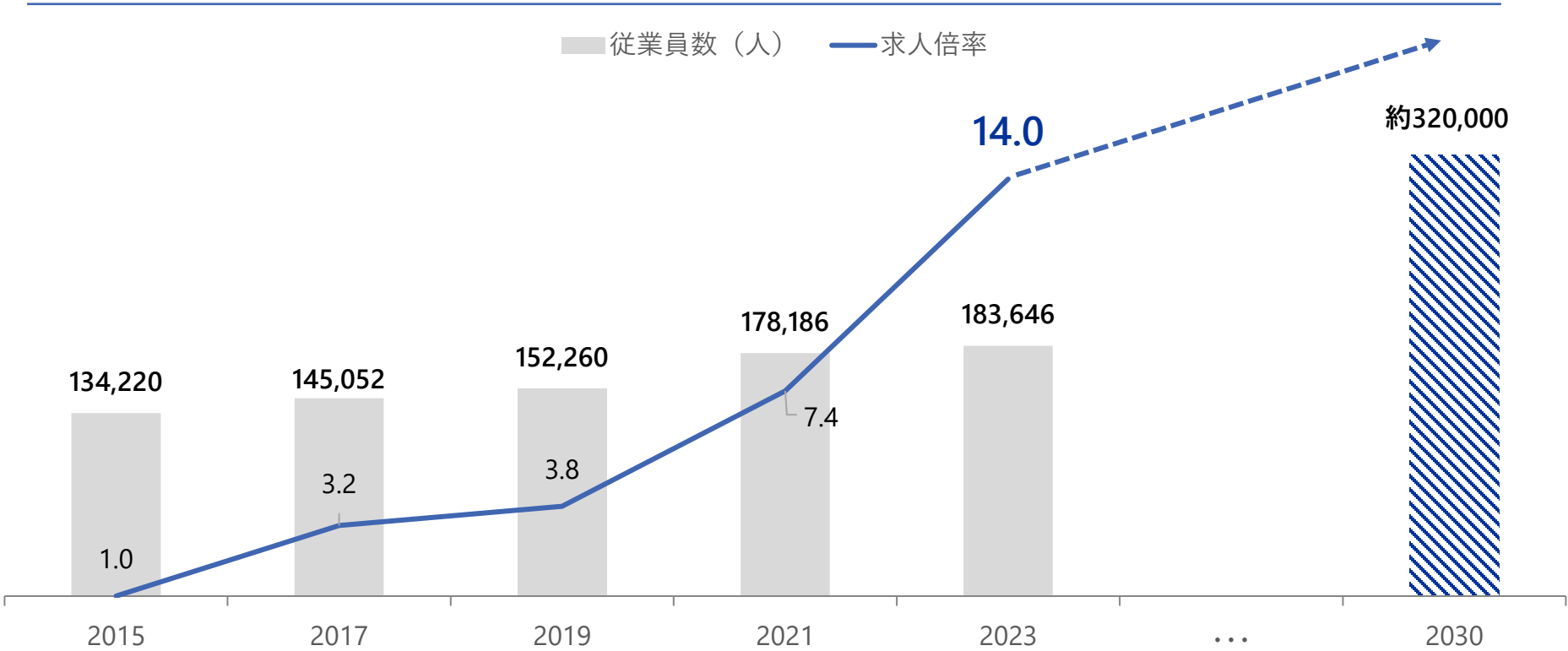
国内半導体工場の現状 半導体業界の人手不足

半導体業界は深刻な人手不足

- 半導体関連産業の人材数は増加傾向にあるが、既に人材が不足している状況であり、求人倍率は著しく上昇
- さらに半導体工場の新規建設等により2030年までに追加で約14万人が必要となるとの見解（SEMI）

人材供給が半導体関連産業のボトルネックとなりうる

半導体関連産業の人材動向およびエンジニア求人倍率



出所：

*1 経済産業省「工業統計調査」、「経済構造実態調査」

*2 日本経済新聞（SEMI幹部「2030年、世界の半導体人材150万人不足」2024年12月12日記事）

AGENDA

第1部 2026年11月期3Q 連結業績エグゼクティブサマリ

第2部 成長戦略—中期経営計画

第3部 事業の基礎情報

事業概要・市場環境・**競争優位性**

Appendix

当社の価値源泉

①プラットフォーム力及び②エンジニアリング力による製造支援にて価値創出を実現



従来のサプライチェーン課題

老朽化装置の部品不足

災害によるサプライチェーンの寸断

不要装置の処理

エンジニア等の人材不足

競争力の低下

半導体製造装置の老朽化

製造イノベーション

プラットフォーム力

- 装置・パーツの供給情報
- 半導体工場の需要情報
- 半導体製造周辺に関連する新規プラットフォーム構築力

エンジニアリング力

- 装置解体、搬出、設置
- 生産性改善提案
- プロセスチューニング

TMHの提供する価値

越境EC：調達ルート確保

部品の修理、調達

半導体人材プラットフォーム提供

装置解体/輸出

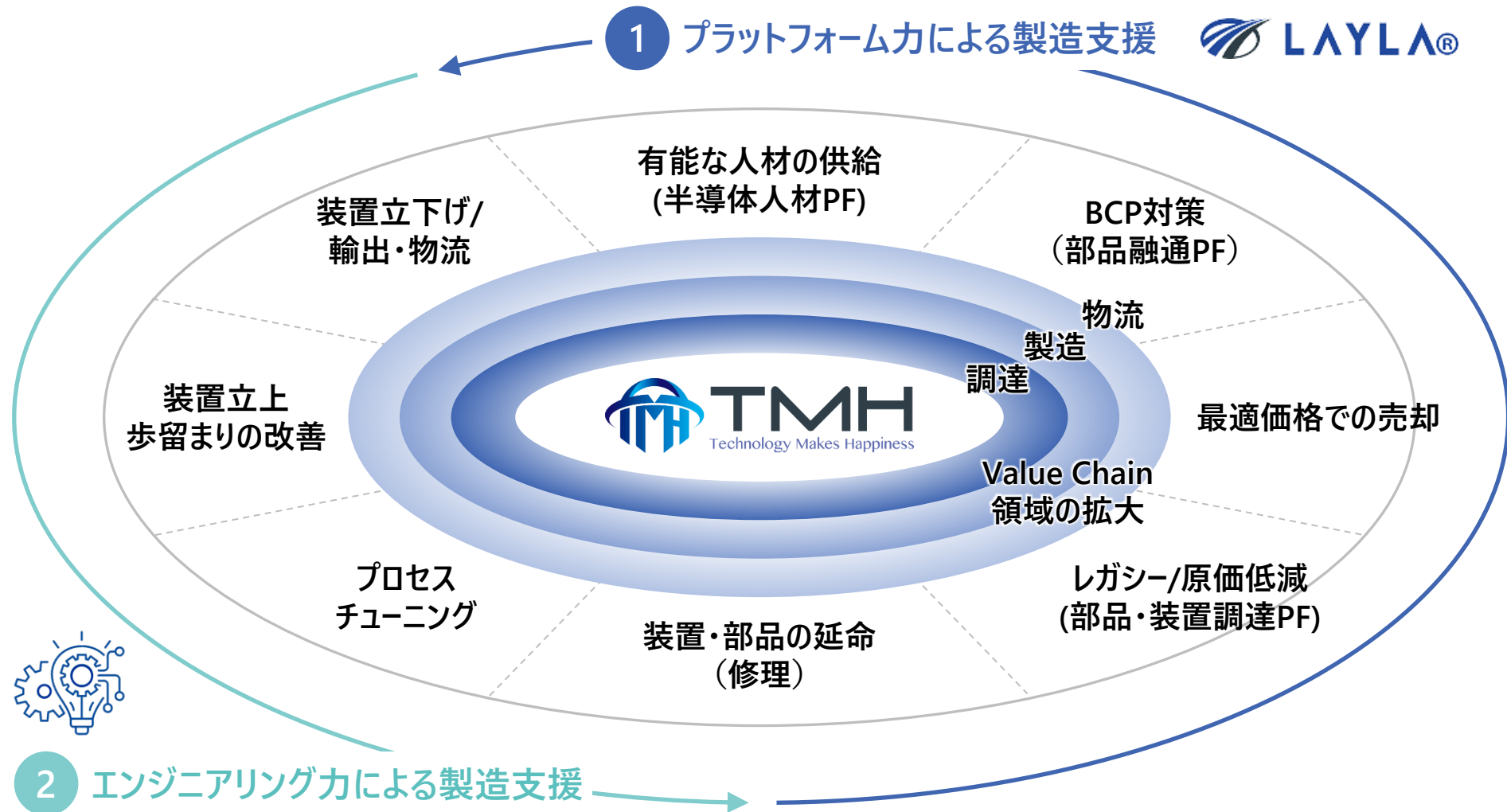
装置立上/改善

最終製品の機能改善

①プラットフォーム力 × ②エンジニアリング力により、顧客の様々な課題を解決

企業の収益向上と価値創出を実現

- 半導体工場の課題解決を通じて様々な案件に触れることにより、ノウハウや課題解決力が向上
- 半導体製造に関わる情報集約型企业として安定的な成長へ

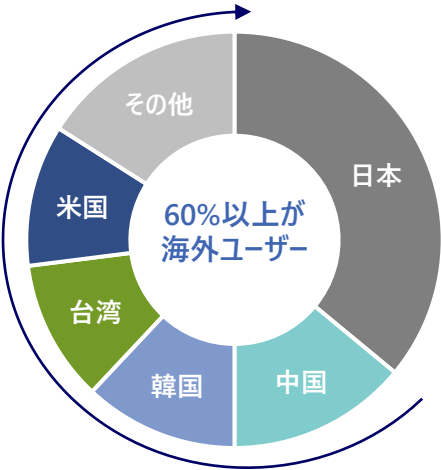
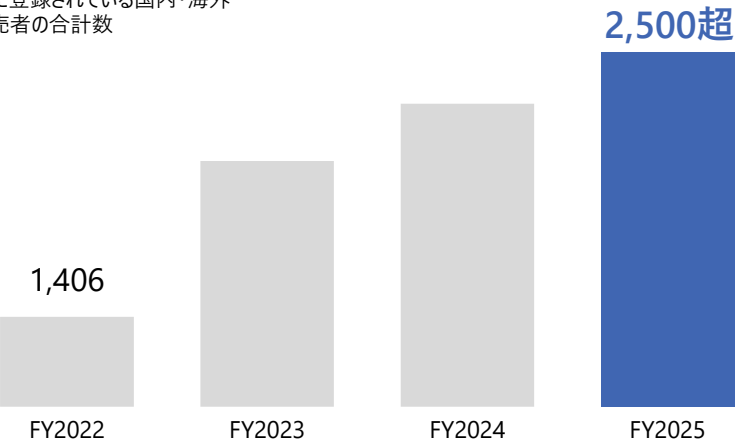


プラットフォーム力
LAYLAは半導体業界に不可欠なプラットフォームへ

- LAYLA-ECは、半導体工場にとって重大な課題となっていた部品調達等を解決するプラットフォームとして、グローバルに拡大を続ける
- 国内においても半導体工場の**50%超がLAYLA-ECを導入済み**。国内半導体製造における重要な役割を担う

グローバルに拡大を続けるユーザー基盤

ユーザーは、LAYLAに登録されている国内・海外
全ての購入者・販売者の合計数



LAYLA-ECがユーザーへ提供するプラットフォーム価値

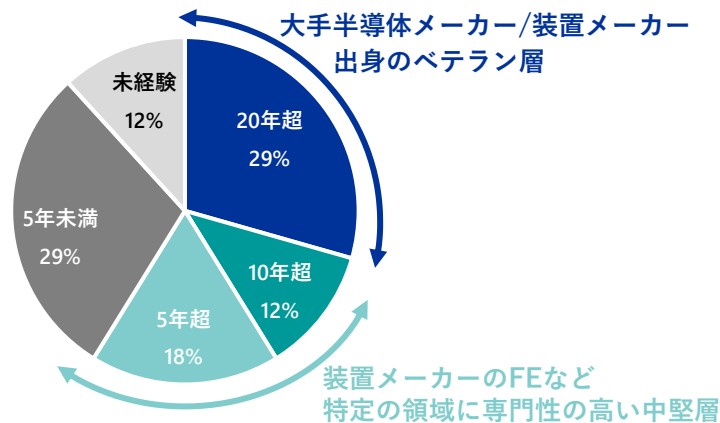
グローバルに広がる調達手段	埋没在庫の可視化	×エンジニアリング力
多言語対応、越境決済、貿易手続等、 複雑な越境取引をLAYLA-ECにより容易化	LAYLA-ECを使用することで、世界中の工場に点在する “埋没”している部品等を可視化	部品等の流通のみではなく、代替品の発掘 (目利き) や監査による品質を維持
従来調達方法では困難であった 越境調達が可能	レガシー工場にとって 最も有効な調達手段として確立	単なる部品調達ECに留まらない サービスの提供

エンジニアリング力 グローバルで評価される専門家チーム

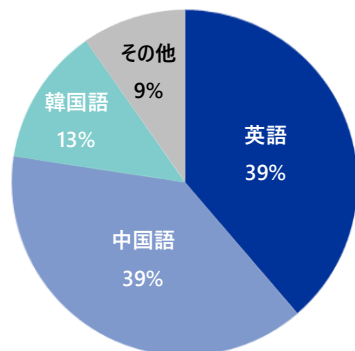
- 半導体分野のプロフェッショナルが厚く在籍。また、半導体分野の主要各国の言語能力も有し、現地の商慣習にも精通したメンバーを擁する陣容
- 調達から立ち上げ、延命、改善まで技術的課題の解決に一气通貫して対応できるエンジニアリング力を発揮

米国大手半導体メーカーからサプライヤーアワードを受賞するなど、グローバルから評価

経験豊富かつ市場に希少なベテラン・中堅層



半導体主要各国に関する言語能力



出所：2025年11月末時点（管理部門を除く）

フィールドエンジニアリング

中古半導体装置の販売を行うのみでなく、解体、搬出（設置）およびプロセスチューニング（装置の最適化）等、「レガシー装置」を熟知したベテラン・中堅エンジニアが、生産性改善から稼働延命まで一气通貫で支援。

ノウハウの複利効果

グローバルに広がるLAYLAプラットフォームにより、世界中の知見、商慣習、情報を集約。経験豊富なエンジニアとのシナジーにより、競合他社には模倣が困難なエンジニアリング力を実現。

目利き力

半導体工場が調達困難な部品等であっても、代替品の可能性や海外も含めてソーシング対応。品質を判断する目利き力により「購入してみたものの期待通りに機能しない」といった、中古部品等の重大リスクを最小限に削減。

ポジショニングマップ

独自のポジショニングを確立し、ニッチトッププレイヤーとしての市場を創造

競合と当社のポジショニング比較



当社の優位性・参入障壁

01 エンジニアリング力による高付加価値 vs リース会社、商社

- プラットフォームを活用した情報力、高度なエンジニアリング力に基づく知見を有する
- 半導体製造装置の立上げやプロセスチューニングといった高度な支援を提供

02 レガシー工場、マルチベンダー対応 vs 半導体製造装置メーカー

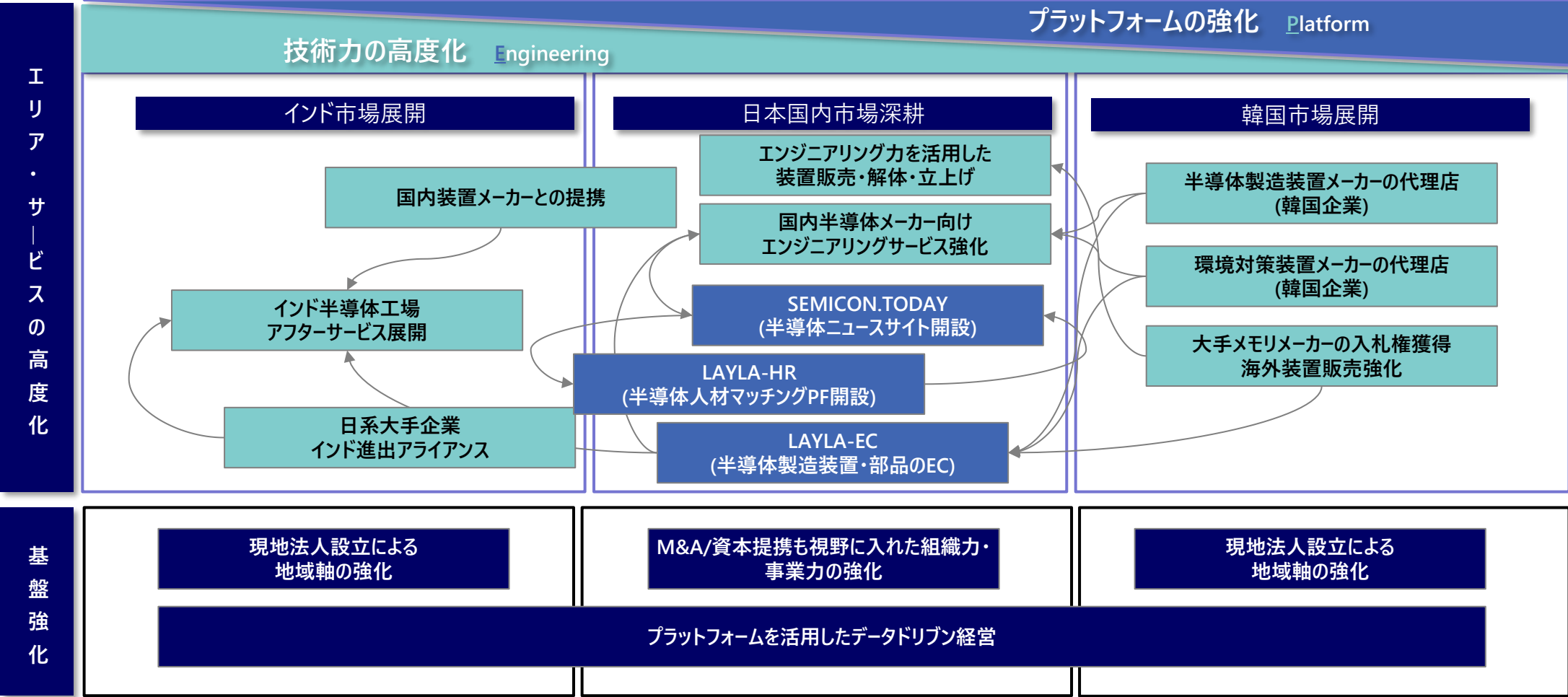
- 装置メーカーは先端工場に対して支援が厚いが、当社はレガシー工場も含めて広く半導体工場を支援
- 装置メーカーは自社製品を中心に扱うが、当社は全ての製造装置メーカーの商材を扱い、幅広いサービスラインナップを提供

03 強固な顧客基盤 vs 新規参入

- 半導体製造領域は技術的な知見を必要とし、また当社は、既に日本全国に顧客基盤があり多くのシェアを獲得していることから、参入障壁を高く保持することが可能

中期的なマージンターゲットを実現するための施策
市場・サービス拡大により、売上(流通総額)180億円超、営業利益17.6億円を目指す

売上(流通総額)180億円超 営業利益17.6億円
Aim 2028



Appendix

FY2026業績予想の前提

(単位：百万円)	連結業績予想額		前提
売上高	3,179		
装置販売	1,958		・ 装置販売サービスは、現時点の受注残および販売計画に基づき試算しております
部品販売・修理サービス	1,221		・ 部品販売・修理サービスは、前年実績および営業活動進捗に基づき試算しております ・ 半導体工場の稼働が増加することで売上も増加する特性があります
売上原価	2,735		・ 売上原価は、装置販売の利益率および部品販売・修理サービスの販売額に応じて変動します ・ 当期4Qに見込む装置在庫の評価損を織り込んでおります
販売費及び一般管理費	719		・ 前年実績及び増加人員や展開計画にあわせて費用を試算しております
営業外損益	営業外収益 14	営業外費用 23	・ 前年度実績等に基づき試算しております ・ 為替影響については、基本的に装置販売サービスのような大型案件は円建て取引とすることで為替リスクを極小化しています ・ また、部品販売・修理サービスは外貨建て取引があるものの、売上計上と入金及び仕入計上と支払のタイミングが近いため、影響は軽微なものとして想定しております

本資料は、株式会社TMH（以下「当社」といいます。）の企業情報等のご案内のみを目的として当社が作成したものであり、当社の有価証券の投資勧誘等を目的としたものではありません。

本資料に記載されている情報は、現時点の経済、規制、市場等の状況を前提としています。
本資料には、将来の予想に関する記述が含まれています。これら将来の予想に関する記述は、当該記述を作成した時点における情報に基づいて作成されています。これらの記述は、将来の結果や業績を保証するものではありません。

このような将来予測に関する記述には、既知および未知のリスクや不確実性が含まれており、その結果、将来の実際の業績や財務状況は、将来予想に関する記述によって明示的または黙示的に示された将来の業績や結果の予測とは大きく異なる可能性があります。

本資料に記載されている当社以外の企業等に関する情報および第三者の作成に係る情報は、公開情報等から引用したものであり、そのデータ・指標等の正確性・適切性等について、当社は独自の検証は行っておらず、何らその責任を負うことはできません。